

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2023-030

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟向招商银行咸阳分行、中信银行西安分行分别申请不超过 5000 万元的综合授信额度（综合授信总额度不超过 1 亿元）。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间的付款结算，提高资金使用效率，公司 2023 年度拟向招商银行咸阳分行、中信银行西安分行分别申请不超过 5000 万元的综合授信额度（综合授信总额度不超过 1 亿元），总额授信均为信用方式，授信额度期限为自董事会审议批准之日起 12 个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、流动资金贷款、信用证等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行授信额度内，提请授权公司董事长代表公司签署一切综合授信相关的法律文件。提请授权公司财务总监协助公司具体落实上述综合授信的相关手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023年4月26日